

深圳市信维通信股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、报告期内公司从事的主要业务

坚守公司使命，为客户创造价值。公司始终坚守“致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价值”的使命，以材料为核心，通过对研发的持续投入，保持与国内、外知名大学和科研院所的合作与交流，加大对基础材料、基础技术的研究和积累，并以材料驱动业务发展，不断深化“材料->零部件->模组”的一站式研发创新能力，为客户提供更丰富的产品和解决方案。

践行公司核心价值观，实现可持续发展。公司坚持以本分、客户满意、结果导向、追求极致、勇于担当为核心价值观，共识、共创、共担、共享，打造有战斗力的合伙人团队，通过多年与客户建立的良好合作关系以及持续的新业务拓展，实现可持续发展。在聚焦主业上，公司始终保持着较强的战略定力及战略落实、推进力，夯实消费电子核心领域业务的同时，积极挖掘新兴领域机会，布局具有前景的新兴产业项目，努力把产业做透做强，在市场波动以及持续动荡的外部环境中，为公司的长期健康发展积蓄力量，不断获得新的成长动能。

报告期内，公司主营业务包括天线及模组、无线充电及模组、EMI\EMC 器件、高精密连接器、汽车互联产品、被动元件等产品，可广泛应用于消费电子、物联网/智能家居、商业卫星通信、智能汽车等领域。

信维通信是一家全球研发、运营、销售的公司，业务与客户已遍及全球。迄今，公司在全球拥有 26 家子公司、11 个研发中心和 5 个主要生产基地，员工 13600 人，业务覆盖 8 个国家 18 个地区。

二、经营情况概述

2024 年，在宏观经济发展稳中有进、消费电子市场复苏回升的背景下，公司保持原有业务优势的同时，积极推进四新业务（新行业、新客户、新技术、新产品），第二增长曲线业务在前期投入的基础上，得到了较明显的发展。报告期内，公司实现营业收入 874,361.06 万元，较上年同期增长 15.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 66,160.55 万元，较上年同期增长 26.89%；实现归属于上市公司

公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,810.68 万元,较上年同期增长 22.31%,公司全年经营业绩实现了较快提升。

报告期内,公司天线、无线充电、精密结构件等业务持续保持市场优势,导入更多客户产品;高精密连接器、LCP 模组/毫米波天线、声学器件、UWB、汽车互联产品、缝隙波导天线、被动元件等新业务也逐步获得更多业务机会。除消费电子外,公司在商业卫星通信、智能汽车等应用领域取得了明显进展,逐步实现从消费电子到“消费电子+卫星通信+智能汽车”多业务发展阶段的跨越,为公司业务规模的扩大提供重要增长力量。

在公司的产品线中,天线一直是公司最核心也最具竞争力的产品类别。2024 年 6 月,公司凭借移动终端天线领域深耕积累的产品实力、行业地位、市场份额等多方面优势,成功获评由国家工业和信息化部发布的“制造业单项冠军企业”荣誉称号,体现了公司坚守主业,勇于攀登细分领域行业制高点,努力成为制造业细分领域发展领头雁、排头兵的坚持与决心。在高精密连接器方面,公司依托自身射频技术、磁性材料等技术优势,重点发展高速连接器、磁性连接器、BTB 连接器等高端细分领域,相关产品技术水平深受客户认可,除消费电子市场外,在商业卫星通信领域取得快速突破,业务规模持续扩大,已逐步成长为公司第二个主要下游应用领域;公司的高频高速连接器取得了在汽车和卫星通信等领域的突破。在 LCP 及毫米波天线模组方面,公司自主研发的 LCP 薄膜通过了美国 UL (Underwriter Laboratories Inc.) 认证,高频传输性能及可靠性等处于国内领先水平,已服务北美大客户,同时针对移动通信、智能网联汽车、卫星通信等相关领域的客户共同开展基于以 LCP 为代表的高分子先进材料的多种形态高性能毫米波天线解决方案的研究。在 UWB 业务方面,公司已有丰富的技术储备及专利布局,成功应用于智能汽车钥匙、智能门锁、智能医疗设备、智能安防、智能音响等物联网及智能家居产品,实现了公司在智能汽车、物联网/智能家居应用领域的业务拓展。随着客户产品智能化发展,公司的高精密结构件产品也取得新的业务进展,为配合终端设备更高密度电池的升级,公司已为客户提供可有效抵抗外部环境侵蚀和损伤且兼具轻薄性的不锈钢电池壳,这将帮助终端设备提高电池续航能力、带来更好的使用体验,随着客户需要的增加,未来公司这一业务的规模还将进一步扩大。在被动元件业务方面,公司持续完善深圳-日本-韩国-常州-益阳多地国际化研发体系及高端人才梯队建设,瞄准被动元件高端定位,成

功研发的多款高端 MLCC 产品均已通过了大客户的测试,正逐步量产,并在材料、配方、先进工艺和关键设备等方面获得专利 60 余项,有力填补了国内高端 MLCC 技术空白;随着 AI 服务器等新兴领域的发展,高容、宽温等高端 MLCC 产品有明显的需求增长,公司将逐步形成 AI 服务器高端 MLCC 产品系列化布局。

智能汽车是公司另一重要下游应用领域,是公司产品应用的重要战略布局。公司积极拓展自有技术产品在该领域的应用突破,加大对客户及产品的拓展。截至报告期末,公司已取得更多国内外主机厂及 Tier1 的供应资质,并就车载天线、无线充电、USB Hub、线缆及连接器、Busbar、EMI\EMC 器件及精密结构件等产品达成了较明确的合作方向,预计在未来 2~3 年为公司的成长提供支撑。

随着公司业务规模的扩大以及对以技术驱动为导向战略目标的坚守,为吸收全球不同国家、地区的技术、人才优势,也为应对多变的国际贸易局势,公司的国际化布局最早在 2012 年开始,并于 2019 年在越南建立了公司的第一个海外生产基地;2024 年,公司又在墨西哥新增建立了第二个海外生产基地,并于同年完成对越南生产基地的扩建,进一步加大海外产能建设及业务规模,公司的国际化布局得到进一步完善,实现与全球客户的多元化合作。目前,公司已在全球拥有 26 家子公司、11 个研发中心和 5 个主要生产基地,业务覆盖 8 个国家 18 个地区。同时,公司也在深圳建设新总部基地,强化深圳技术研发+智能制造的核心作用。此外,为降低单一业务领域对公司生产经营的影响,公司近几年一直努力打造第二增长曲线业务。公司在商业卫星通信、智能汽车等新兴产业领域,已获得许多国内外客户认可,预计未来 2~3 年,公司新产品、新兴应用领域业务及国内业务的占比将进一步提高,原有单一业务领域占比相对降低,单一地区、业务对公司生产经营影响的风险可控。

在电子信息技术不断变革的快速发展浪潮下,公司坚守“致力于通过对基础材料、基础技术的研究,创造出值得信赖的创新产品与解决方案,为我们的客户创造价值”的使命,重视研发投入,积极把握技术创新趋势,挖掘客户需求,将技术驱动融合在产品服务中,始终保持着源源不断的技术创新活力。截至 2024 年 12 月 31 日,公司共申请专利 4782 件;2024 年 1 月至 12 月新增申请专利 814 件,其中 5G 天线专利 267 件, LCP 专利 11 件, UWB 专利 23 件, WPC 专利 32 件, BTB 连接器专利 18 件, MLCC 专利 41 件、声学结构专利 271 件。报告期内,公司研发投入约 70,803.27 万元,占公司 2024 年营业收入的 8.10%,保持较高的研

发强度，不断积累自身在基础材料、基础技术上的核心能力：

(1)基础材料：以村田、TDK、京瓷等优秀企业作为学习标杆，公司持续夯实高分子材料、磁性材料、陶瓷材料、散热材料等核心材料平台，加强在核心材料上的技术投入。在 高分子材料领域，公司具有深厚的研发实力和丰富的应用经验，我们开发的 LCP 薄膜、LCP 柔性覆铜板、MPI 柔性覆铜板等产品目前已在国内外消费类终端客户的 RF 传输线、毫米波传输线、UWB 天线等应用领域实现量产，公司可为客户提供从薄膜材料到模组的一站式解决方案，在高频高速方案中有着广泛应用；LCP 薄膜作为公司自主开发的核心材料之一，它具有耐高温且热稳定性好、高频信号下传输损耗低、占用空间小等优点，在 5G 通信领域产品中已经大量使用，同时公司开展了 6G 前沿技术及先进材料的研发，应用前景会更加广泛。除了对已有产品的创新升级外，公司不局限于单一材料或技术的研发，积极探索同一材料在多个行业（如汽车、工业、航空等）的应用挖掘，以实现更广泛的商业价值和市场竞争力。在磁性材料上，公司有着深入而广泛的研究，已开发高频高功率低损耗磁性材料，是下一代无线充电技术的核心材料，在国内外客户移动终端的发射端均已有应用并供货；另外，磁性材料还可帮助公司提升天线、射频模组等多类产品的竞争力。在陶瓷材料上，公司具备陶瓷材料和基础配方等研发能力，对 MLCC 等产品的生产具有重要意义，有助于降低生产成本，提高产品质量，增强公司产品的市场竞争力；公司研究的高频低损耗陶瓷材料在通信领域有很好的应用，特别是在高频通信和微波通信领域；通过对陶瓷材料应用的深入研究，可以进一步提升天线、阻容元件等产品性能，为客户提供更优质、高效的通信解决方案。在散热材料领域，公司已为北美客户提供核心芯片封装散热器件。

(2)基础技术：公司依托以中央研究院为核心的全球 11 个研发中心，开发前沿技术产品。公司在射频领域拥有显著的研发实力和技术优势，围绕 5G-A/6G 的技术目标，积极开发柔性可重构天线、卫星通信相控阵天线、毫米波雷达缝隙波导天线、高频封装天线、光学透明天线、UWB 天线模组等。随着 5G-A/6G 技术的不断发展，对终端天线模组的要求也越来越高，天线模组需要能够支持更高、更宽的频带范围，以确保在各种通信场景下都能实现稳定的信号传输；而终端设备的不断小型化和轻薄化，对天线模组的尺寸和集成度也形成了严格的限制，对天线材料及工艺也提出了更高的要求，公司对 5G-A/6G 天线模组做了大量的研究工

作，公司还在无线充电领域储备了 NFC 无线充电、Qi2.0/Ki、高自由度充电技术等；在高速连接器领域正在开展满足高频高速需求的轻量化、低 Dk 介电材料的研发。

未来，公司将积极把握产业创新的机会，始终坚持对基础材料、基础技术的研究与投入，不断夯实企业核心竞争力、加强公司的运营能力，努力成为一家“产品领先+卓越运营”的技术驱动型企业。同时在内部管理上，公司还将继续强化预算管理、风险控制，不断探索更好的内部管理机制，完善内部管理措施，优化企业经营指标，履行 ESG 社会责任，坚持走绿色可持续发展道路，实现财务指标的稳步改善。

三、报告期内董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

- 公司第五届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。
- 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
- 2、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
- 3、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
- 4、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
- 5、审议通过了《关于公司<2023 年内部控制自我评价报告>的议案》
- 6、审议通过了《关于公司<2023 年度可持续发展报告>的议案》
- 7、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
- 8、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
- 9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》
- 10、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
- 11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》
- 12、审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
- 13、审议通过了《关于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况的议案》
- 14、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
- 15、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

16、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

● 公司第五届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室召开。

1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

● 公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室召开。

1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

4、审议通过了《关于公司<第四期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

5、审议通过了《关于公司<第四期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股权激励计划有关事项的议案》

7、审议通过了《关于<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

8、审议通过了《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》

10、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

● 公司第五届董事会第十一次会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室召开。

1、审议通过了《关于向第四期股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

● 公司第五届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。

1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

四、公司未来发展的展望

（一）2025 年发展展望

2025 年，虽然国际形势充满不确定性，但伴随着各种创新技术的出现，以及市场需求进一步恢复，预计公司所处行业市场景气度保持回升，既充满了机会，也存在挑战。公司在对基础材料、基础技术持续投入的基础上，提高核心竞争力、加强精细化管理、提高运营效率，同时积极迎接挑战，加快第二增长曲线业务实施，优化自身业务结构，深化客户合作，加强团队建设，做好全面预算管控，提升公司在客户端的竞争力。此外，公司重点加大在战略产品线的投入和发展，逐步实现产品领先，关注毛利率、净资产收益率等财务指标的提升、改善，进一步

加强内部运营及预算管理等能力，增加抗风险能力，降本增效，实现公司经营业绩的持续增长。

1、在技术投入方面，公司将持续加强对高分子材料、陶瓷材料、磁性材料、散热材料、功能复合材料等核心材料为代表的基础材料和相关基础技术的研究，进一步提升公司核心材料技术能力，进而提升公司在消费电子、商业卫星通信、智能汽车等领域的 5G/6G 天线、毫米波天线、LCP 模组、高性能精密连接器、无线充电、被动元件、UWB 模组等产品的竞争力。以为客户创造价值为最终目标，通过技术创新、产品领先提升公司竞争力。与此同时，公司积极开展基础材料、基础技术预研工作，在深耕通信及消费类电子行业的同时，已逐步进入商业卫星通信、智能汽车等行业，并前瞻性布局 6G、7G、数据中心、人工智能、人形机器人等新兴领域，为公司未来成长拓展空间。

2、在业务拓展方面，公司继续深耕消费电子业务的同时，加快第二增长曲线业务的拓展力度，提高公司的抗风险能力。公司继续巩固天线及模组、无线充电模组、EMI\EMC 器件等消费电子业务在客户端的优势地位，加大对新业务、新客户的拓展，提升消费电子业务的市场占有率。公司加快推进声学、高性能精密连接器、汽车互联产品、缝隙波导天线、UWB 模组、被动元件等新业务的客户覆盖，争取快速提升新业务等经营规模。目前已完成商业卫星通信、智能汽车、数据中心、人工智能等行业的前期客户布局与部分产品导入，预计未来 2-3 年将会迎来业务规模的进一步提升。

3、在客户合作方面，提升与客户在战略层面的合作，进一步加强对客户技术路径趋势和前沿技术的跟踪、预判，强化销售端-中央研究院-事业部的内部协同，加快新产品、新技术在客户端的推广落地。同时，公司会加强境内客户的业务开拓，从消费电子到商业卫星通信、智能汽车、数据中心、人工智能等领域加快国内客户的合作，也会考虑收并购的方式迅速完成国内业务的落地布局。

4、在团队建设方面，需在核心岗位的能力培养和人才引进上继续花大力气，大力提拔有能力、有成就动机的年轻人，进一步实现公司管理团队的年轻化、专业化、国际化。

5、公司继续提升 EMT 集体领导决策机制的运作效率，通过全面的预算管理加强对各事业部的管控，严格执行费用预算，实现降本增效；加快资金周转速度，提高资金使用效率，合理安排资金的使用，保障公司稳步健康的发展。

6、在实施新一期股权激励计划的基础上，持续对公司的奋斗者、贡献者进行激励，积极推进共识、共创、共担、共享的合伙人文化。

2025 年，虽然外部环境依然有挑战，但公司管理层已做好应对准备，对完成 2025 年目标充满信心。未来，公司不忘初心，坚定对基础材料、基础技术的研究，拓宽技术的护城河，致力于成为“卓越运营+产品领先”的企业，力争为全体股东带来长期良好回报。

（二）2025 年公司发展面临的挑战及应对措施

公司未来整体业绩表现的不确定因素及应对措施如下：

1、经营风险

（1）外部经济变化的影响

外部环境形势复杂多变，宏观环境对产业的影响，都会给企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性，从而对公司的经营产生一定的影响。针对此风险，公司一方面加深与客户的合作，做好客户及市场变化的预判，争取更多的市场份额，同时也加大对新产品、新技术的研发投入，加大重要客户新产品的营收占比，培育新的收入增长点；另一方面，公司除了维持在消费电子移动终端领域的领先优势，还将继续加大对物联网、商业卫星通信和智能汽车等应用领域的业务布局及产品开发，降低外部经济变化对公司经营业绩的影响。

（2）行业形势的变化

公司所处行业及所经营的业务具备创新周期短、产品迭代快的特征，现阶段下游需求正在逐步回升，只有坚持持续创新，不断推出有创新力的产品，把握行业创新的市场机会，才能不被市场淘汰。公司保持较高比例的研发投入，并通过持续的研发投入来保证产品在技术上的领先性。公司致力于打造技术驱动型企业，重视在主要产品生产规模和工艺技术方面的较强市场竞争能力，并且在行业趋势上显现出良好的发展前景，但如果公司在业务拓展的过程中未能在生产、管理、营销、技术等方面持续占据竞争优势，未来将面临一定的市场竞争风险。

（3）汇率波动的不确定性

公司的出口销售和原材料进口以美元结算为主，随着国际政治、经济环境的不稳定性因素变化，公司会面临汇率波动的不确定性。未来，公司持续加强外汇管理，做好外汇汇率波动的前瞻性预测，提前做好相关的风险对冲准备，降低汇率波动对公司的影响。

2、管理风险

近年来，随着业务的不断拓展，公司内生式增长与外延式发展同步进行，公司子公司、参股公司增多，产品线愈发丰富，员工规模相应增长，现有管理制度及管理体系面临诸多新挑战。如果公司管理层对公司现行治理架构、内部管理流程和人员结构的调整完善无法适应公司快速发展的需要，将使公司管理风险增大。

公司管理层已充分意识到在快速发展的过程中可能存在一定的管理风险，这就要求公司进一步对现有管理架构进行完善与优化，加强对子公司、参股公司管理团队合规运营理念的宣导，定期开展系统性的管理培训，严格执行内控与预算管理，做好公司整体战略计划的贯彻落实。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日